

捷普宣布以 22 亿美元剥离移动电子制造业务的最终协议 已完成签署

捷普（纽约证券交易所代码：JBL）今天宣布将其移动电子制造业务以 22 亿美元的现金交易剥离给比亚迪电子（国际）有限公司（“比亚迪电子”）的最终协议已完成签署。最终协议是在两家公司于 2023 年 8 月 27 日宣布了初步协议之后达成的。

根据协议，生产消费电子产品零部件的捷普移动电子制造业务将转移给比亚迪电子。该业务主要位于中国成都和无锡。

捷普首席执行官 Kenny Wilson 表示：“我们很高兴与比亚迪电子达成这一最终协议，并相信这一交易是本公司、我们的员工，和客户向前迈出的正确一步。交易完成后，捷普将有能力加强其以股东为中心的资本框架，包括逐步增加的股份回购。此外，它将为进一步投资电动汽车、可再生能源、医疗保健、人工智能云数据中心和其他终端市场提供机会。”

该交易预计将在捷普当前的 2024 财年的前两个季度（即 2023 年 9 月 1 日至 2024 年 2 月 29 日期间）内完成，并取决于成交条件，包括所需的监管批准。

正如之前宣布的那样，在即将发布的收益发布和第六届年度投资者简报会上，捷普将以电话会议和网络直播的方式来回顾第四季度和 2023 财年的业绩。此外，首席执行官 Kenny Wilson 和管理团队成员将概述下一财年的策略和财务优先事项，包括与最终协议相关的其他资讯。

高盛（Goldman Sachs & Co. LLC）和加拿大皇家银行资本市场（RBC Capital Markets）担任捷普的独家财务顾问，世达律师事务所（Skadden, Arps, Slate, Meagher&Flom LLP）担任捷普在本次交易中的法律顾问。

点击链接，查看更多相关内容：

[Jabil Announces Definitive Agreement to Divest Mobility Business for \\$2.2 Billion | Jabil](#)